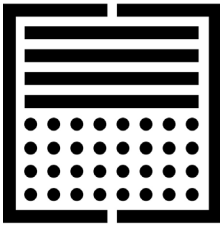


Call for Papers



11. Symposium Connectors

Elektrische und optische Verbindungstechnik

17. - 18. März 2027

Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM) lädt in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und dem VDI Ostwestfalen-Lippe Bezirksverein e.V. herzlich zur Teilnahme am **11. Symposium Connectors vom 17. bis 18. März 2027** in Detmold ein. Die Tagung findet 2027 erstmals in den Räumlichkeiten der Stadthalle Detmold statt.

Die zweijährlich ausgerichtete Fachtagung Symposium Connectors bietet eine etablierte Plattform für Industrie, Forschungsinstitute und Hochschulen, um neueste Entwicklungen und Erfahrungen im Bereich der elektrischen und optischen Verbindungstechnik sowie deren Applikationen anhand hochwertiger wissenschaftlich-technischer Beiträge zu diskutieren.

Interessenten werden gebeten zu folgenden Themen Abstracts einzureichen:

- Kontaktwerkstoffe, Isolierstoffe, Schmierstoffe und Alternativen
- Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Kontaktphysik und Anslusstechnik
- Neue Konstruktionsprinzipien und Miniaturisierung
- KI und intelligente Steckverbindungen
- Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Prüfung
- Hochstrom-, Hochvolt- und Daten-Steckverbindungen
- Optische Verbindungstechnik
- Bordnetzarchitektur, automatische Kabelbaumfertigung und Industrial IoT
- Messtechnik
- Modellierung und Simulation

für alle relevanten Branchen, wie z.B. Automatisierung, Automobil-Bordnetze und E-Mobility, Bahntechnik, Haus- und Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik, Luftfahrt und Medizintechnik.

► Fullpaper

Die Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. Für jede Präsentation, inklusive Fragen und Diskussion, stehen insgesamt 30 Minuten zur Verfügung. Der Download der erforderlichen Formatierungsrichtlinien sowie die Einreichung des Fullpapers und der Präsentation erfolgen über die Homepage der Tagung: www.connectors-symposium.com

► Publikation

Alle präsentierten Beiträge werden in Form eines vollständigen schriftlichen Beitrags (Fullpapers) in einem Tagungsband publiziert, der später auch online im Internet veröffentlicht wird. Mit Einreichung eines Beitrags erklärt der Autor sein Einverständnis dazu.

► Weitere Informationen

Ein Treffen der Teilnehmenden ist im Rahmen einer Abendveranstaltung am 17.03.2027 geplant. Am **Nachmittag des 16.03.2027 findet ein Tutorial** zur Einführung ausgewählter Gebiete statt. Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter www.connectors-symposium.com

Kontakt zum Tagungsbüro per E-Mail: con.sym@th-owl.de

► **Einreichungsfrist Abstracts:** **31.07.2026**
in Deutsch oder Englisch, mit aussagefähigem Inhalt, 1 bis 2 Seiten, mit Angaben von Name, Kurzbiographie des Referenten, Kontaktdaten sowie gewünschte Präsentationsform (Vortrag oder Poster). Die endgültige Präsentationsform wird durch den Programmausschuss entschieden.

► Weitere Termine

Benachrichtigung über die Annahme der Vorträge: **30.09.2026**

Einreichungsfrist des Fullpapers: **31.01.2027**

Einreichungsfrist für die Präsentation: **01.03.2027**

Tutorial: **16.03.2027**

Symposium: **17. bis 18.03.2027**

► Ausstellung

Neben den Fachvorträgen bieten wir auch Ausstellungsflächen für interessierte Unternehmen an. Die Ausstellungsgebühr beträgt 850,00 €. Das Aussteller-Paket beinhaltet die kostenlose Teilnahme am Tutorial sowie an der Fachtagung und der Abendveranstaltung für eine Person. Betrag zzgl. der ges. USt. von 19%.

► Teilnahmegebühr

Vortragende (nur jeweils 1 Vortragender pro Vortrag): **gratis¹**

Ein/erster Teilnehmer je Unternehmen (Vollzahler): **770,00 €¹**

Frühbucher, bei Anmeldung bis zum 15.01.2027: 580,00 €¹

Jeder weitere Teilnehmer eines Unternehmens: **550,00 €^{1,2}**

Frühbucher, bei Anmeldung bis zum 15.01.2027: 380,00 €^{1,2}

Optional zubuchbar:

Tutorial (nur für Tagungsteilnehmer zusätzlich buchbar): **90,00 €**

Frühbucher, bei Anmeldung bis zum 15.01.2027: 45,00 €

Tagungsband, zusätzlich als Druckversion: **60,00 €**

Erwerb vor Ort ist aufgrund der begrenzten Auflage nicht möglich. Nach der Registrierung wird das Tagungsband ab 17.03.2027 zum Download online zur Verfügung gestellt.

¹ Die Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive Tagungsunterlagen in digitaler Form, Abendveranstaltung am 17.03.2027, Mittagessen und Getränke während der Pausen.

² Ein Vollzahler eines Unternehmens erforderlich. Vortragende/r gilt nicht als Vollzahler.

Eine Stornierung einer Anmeldung ist nur bis zum 05.03.2027 gegen eine Bearbeitungsgebühr von 80,00 € möglich. Ein Austausch von Teilnehmern kann kostenlos erfolgen.

Alle Beträge zzgl. der ges. USt. von 19%.

Aussteller und Gruppenanmeldungen sind direkt über das Tagungsbüro con.sym@th-owl.de zu erfolgen.

► Programmausschuss

Wissenschaftliche Leitung:

M. Blauth & J. Song, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

• C. Dandl, Rosenberger Hochfrequenztechnik

• J. Faber, VDE-Prüfinstitut

• S. Großmann, Technische Universität Dresden

• J. Haun, Kostal

• T. Kochjohann, Phoenix Contact

• M. Mainka, Weidmüller Interface

• A. Naß, Harting Electric

• F. Ostendorf, TE Connectivity

• D. Pfaffenbach, Lumberg Connect

• S. Schlegel, Technische Universität Dresden

• R. Schnabel, VDE/VDI - GMM

• P. Stahl, Wieland-Werke

• A. Vogt, Robert Bosch